

メガチップスが Omni Design Technologies の超低消費電力 A/D コンバータ・ フロントエンドを採用 一次世代通信ネットワークを見据える

最新チップは、高速アクセスおよびホームネットワークに向けた高帯域幅通信へのニーズに対応

カリフォルニア州サンノゼ – 2016 年 11 月 16 日 – ASIC（特定顧客向け LSI）および ASSP（特定用途向け LSI）を基盤事業とする世界的な半導体企業である株式会社メガチップスと、高性能で超低消費電力の半導体 IP コアを提供する Omni Design Technologies は、高性能かつ低消費電力のアナログ・フロントエンド（AFE）チップの開発に向けて戦略的パートナーシップを結んだことを本日発表しました。この提携関係により、業界のリーダー的存在である 2 社は協働を開始し、次世代のホームネットワークおよびアクセスネットワーク、産業オートメーションを実現するための差別化されたソリューションおよび製品の提供を目指します。

「メガチップス、Omni Design Technologies の両社とも、通信市場において他社と異なるテクノロジーを送り出しています。」と株式会社メガチップス事業部長の小西正洋氏は話し、さらに「半導体 IP コア業界を牽引する Omni Design Technologies とパートナーシップを結ぶことによって、当社顧客の競争力強化につながる独自の AFE チップを、引き続きタイムリーに開発していくことが可能になります。」と続けました。

Omni Design Technologies の社長兼 CEO、Dr. Kush Gulati は「メガチップスは顧客に対し最先端のシステムソリューションを提供していることで高い評価を確立しています。当社の画期的な SWIFT™テクノロジーに基づく高速で高解像度の A/D コンバータ（ADC）を組み込み、高性能かつ超低消費電力の AFE チップを共同で開発することを嬉しく思います。」と話しました。

▽Omni Design Technologiesについて

Omni Design Technologies (<http://www.omnidesigntech.com>) は有線・無線通信からセンサー接続、IoT に至るアプリケーションで高度に差別化された SoC (systems-on-chip) を実現する、高性能かつ超低消費電力の半導体 IP コアの開発企業です。Omni Design Technologies は革新的な超低消費電力かつ高性能の IC を幅広く提供し、高度に差別化された半導体システムやプラグアンドプレイの SoC 開発を可能にすることを目指しています。Omni Design Technologies は半導体業界での経験豊富な従業員、MIT 出身の世界レベルの技術者、経験豊富な起業家をスタッフとして抱えています。